

导热硅脂

● 产品描述:

TGrease-1 系列 是以有机硅材料为基体，填充多种高性能导热粉末制成，是一种常见的热界面材料，被广泛应用于硬质接触面的导热填充。它具有较低最小压缩厚度 (BLT) 和低热阻等特点，同时具有优异的热可靠性，可以在-40℃ ~ 150℃的温度下长期使用。所有产品可根据客户要求定向开发



● 产品特点:

- 1) 极低热阻，出油率低
- 2) 长期可靠性，使用过程中不会有泵出

● 应用领域:

- ✓ 半导体散热
- ✓ 电源器件
- ✓ CPU散热
- ✓ 裸die散热

● 使用方法:

- ❖ 在涂覆时推荐采用丝网或钢板印刷。如使用丝网印刷推荐使用60~80目的尼龙丝网。刮刀采用硬橡胶材料，硬度70 Shore A左右，刮刀与涂覆表面呈45度左右刮涂。
- ❖ 也可以点胶或者直接刷涂

导热硅脂

● 典型性能参数:

参数	单位	TGrease- 1101	TGrease- 1300	TGrease- 1400	TGrease- 1520	TGrease- 3401
颜色	----	白色	灰色	灰色	灰色	灰色
密度	g/cm ³	2.7	3.4	2.6	2.8	2.6
粘度	Pa·S	140	280	300	300	260
体积电阻	Ω·cm	> 10 ¹³	> 10 ¹³	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰
热阻@50psi	°C·cm ² /W	0.22	0.055	0.07	0.05	0.1
导热系数	W/m·k	1.0	3.0	4.0	5.2	4.0
BLT	μm	40	25	45	45	50
击穿电压	KV/mm	> 6.0	> 6.0	> 0.6	> 0.6	> 0.6
RoHS	---	符合	符合	符合	符合	符合
保质期	Months	12				

● 包装方式:

1KG、2KG罐装

● 存储条件:

室温避光保存